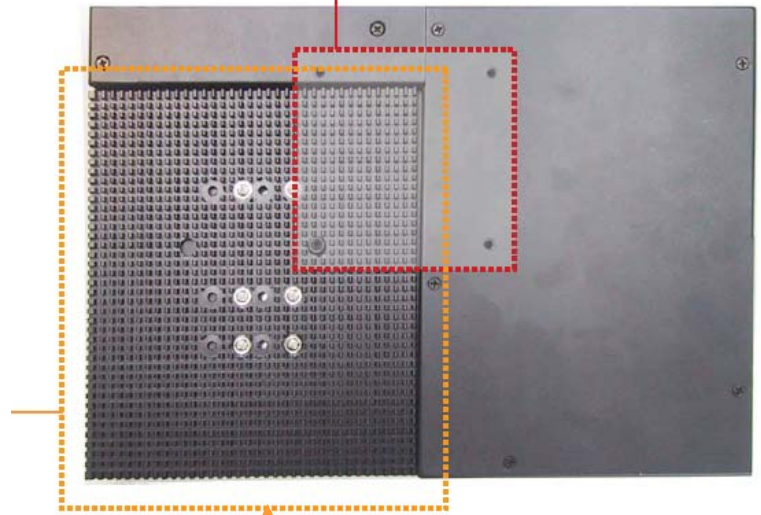


ファンレス設計 / 高信頼性設計

- 回路、機構設計の段階でサーマル・フロー(熱処理)を考慮。
 - ⇒ 筐体背面のヒートシンク(放熱フィン)によって内部に熱を溜めず直接放熱
- 筐体、金型デザインにおいても熱処理を十分に考慮した設計でファンレスを実現
- 産業用の組込みシステムを意識した高信頼性設計(高信頼性の部品も採用)
- ケーブル使用を極力減らしたシンプル設計



VESAアーム取り付け用



ファンレス用サーマルモジュール(一例)